

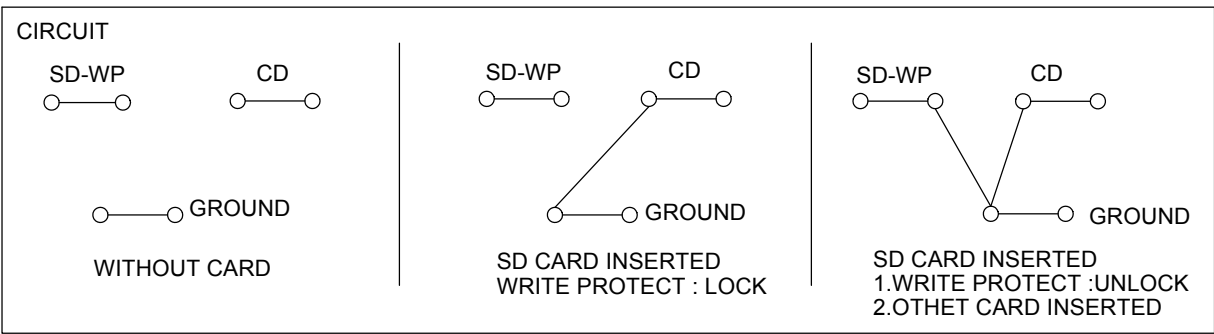
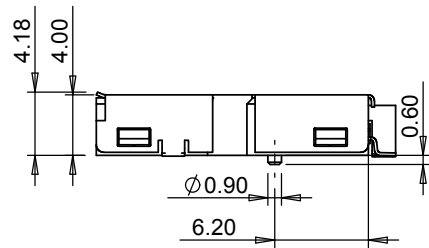
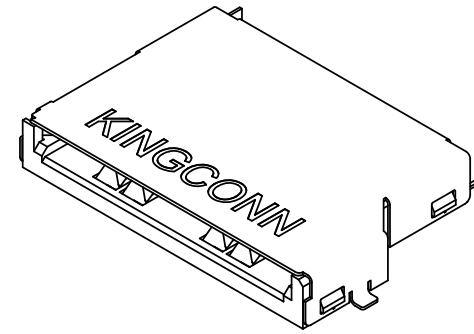
更改 REV	設 變 內 容 MODIFICATION
A	ECN02224
B	ECN02886
C	ECN03841

NOTES :

1. MATERIAL :
 INSULATOR : HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC , UL94V-0.
 COLOR : BLACK
 CONTACT : PHOSPHOR BRONZE.

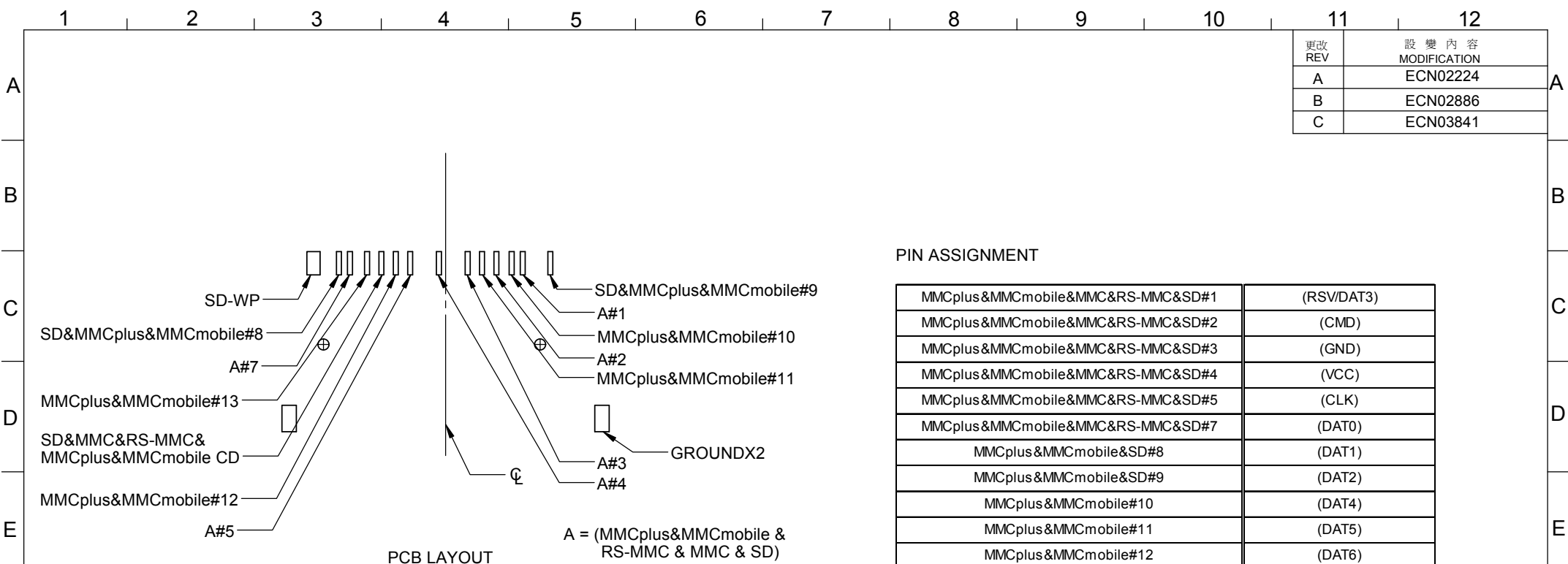
2. PART NO : 7SDMM-X0-2211

PLATING :
 F CONTACT AREA :GOLD FLASH PLATED OVER Ni
 SOLDER AREA : Tin PLATED OVER Ni
 B CONTACT AREA :10μ" Au PLATED OVER Ni
 SOLDER AREA : Tin PLATED OVER Ni



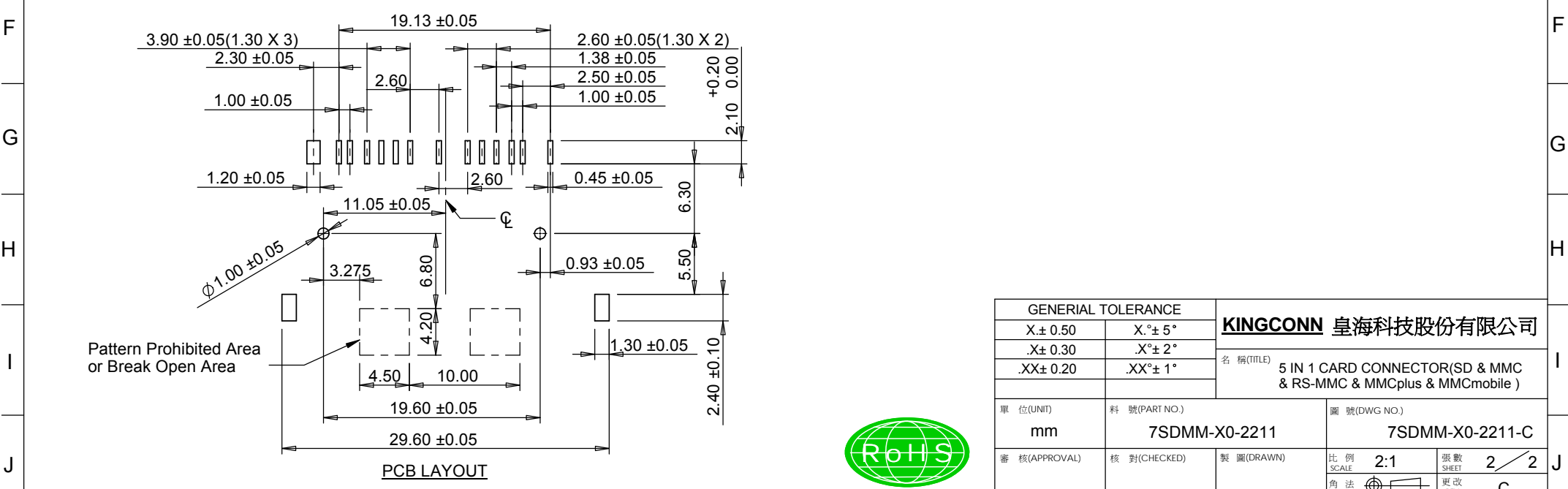
GENERAL TOLERANCE		KINGCONN 皇海科技股份有限公司	
X±0.50	X°±5°	名 稱(TITLE) 5 IN 1 CARD CONNECTOR(SD & MMC & RS-MMC & MMCplus & MMCmobile)	
.X±0.30	.X°±2°		
.XX±0.20	.XX°±1°		
單 位(UNIT) mm	料 號(PART NO.) 7SDMM-X0-2211	圖 號(DWG NO.) 7SDMM-X0-2211-C	
審 核(APPROVAL)	核 對(CHECKED)	製 圖(DRAWN)	比 例 SCALE 2 : 1
			張 數 SHEET 1 / 2
			角 法 PROJ.
			更 改 REV C

更改 REV	設 變 內 容 MODIFICATION
A	ECN02224
B	ECN02886
C	ECN03841



PIN ASSIGNMENT

MMCplus&MMCmobile&MMC&RS-MMC&SD#1	(RSV/DAT3)
MMCplus&MMCmobile&MMC&RS-MMC&SD#2	(CMD)
MMCplus&MMCmobile&MMC&RS-MMC&SD#3	(GND)
MMCplus&MMCmobile&MMC&RS-MMC&SD#4	(VCC)
MMCplus&MMCmobile&MMC&RS-MMC&SD#5	(CLK)
MMCplus&MMCmobile&MMC&RS-MMC&SD#7	(DAT0)
MMCplus&MMCmobile&SD#8	(DAT1)
MMCplus&MMCmobile&SD#9	(DAT2)
MMCplus&MMCmobile#10	(DAT4)
MMCplus&MMCmobile#11	(DAT5)
MMCplus&MMCmobile#12	(DAT6)
MMCplus&MMCmobile#13	(DAT7)



GENERAL TOLERANCE		KINGCONN 皇海科技股份有限公司	
X ± 0.50	X ° ± 5 °	名 稱(TITLE) 5 IN 1 CARD CONNECTOR(SD & MMC & RS-MMC & MMCplus & MMCmobile)	
.X ± 0.30	.X ° ± 2 °		
.XX ± 0.20	.XX ° ± 1 °		
單 位(UNIT)	料 號(PART NO.)	圖 號(DWG NO.)	
mm	7SDMM-X0-2211	7SDMM-X0-2211-C	
審 核(APPROVAL)	核 對(CHECKED)	製 圖(DRAWN)	比 例 SCALE 2:1 張 數 SHEET 2 / 2
			角 法 PROJ. 更 改 REV C

